

回路形成用銅ペースト

【KG-2438シリーズ】

焼結温度、密着強度、焼成雰囲気、安定性改善～回路形成用銅ペースト

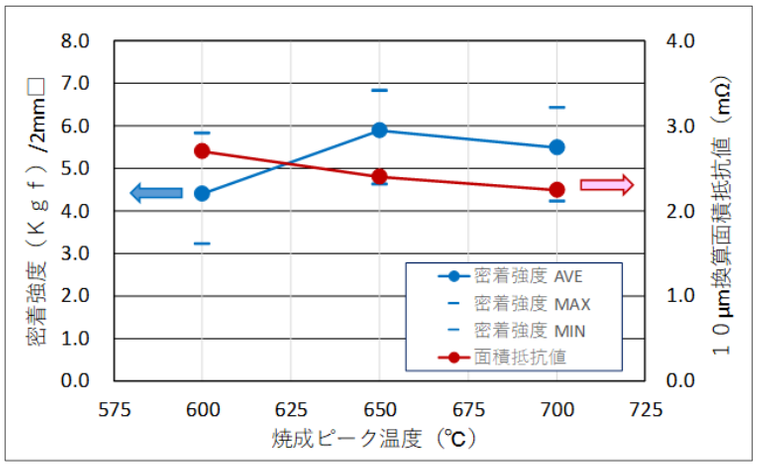
製品特長 Advantage

- ☑ 銅ペーストの特性：銀ペースト並みの低い比抵抗
- ☑ 低い焼結温度を実現
- ☑ 高密着強度で回路信頼性を向上
- ☑ 優れた保存安定性で長期保管が可能

特性 Characteristics

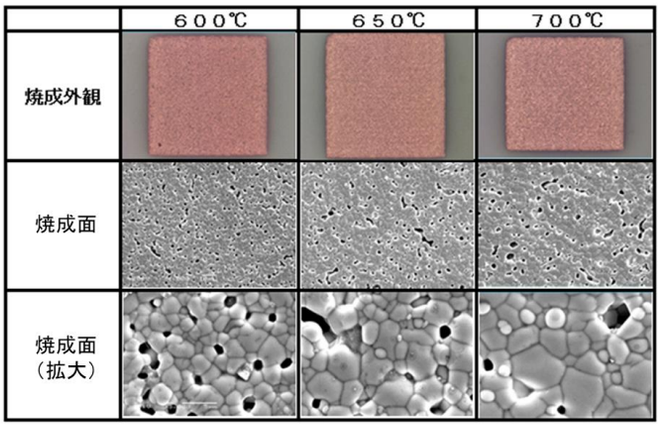
密着強度×焼成温度推移

焼成温度に対する密着強度(※)と抵抗値



焼成膜の状態

焼成温度毎の焼成膜の状態



※ 密着強度：
アルミナ基板上で所定ピーク温度にて焼成したKG-2438の2mm×2mmパッドに、
0.6mmφのワイヤーをはんだ付けしてピール強度を測定

製品仕様

粘度	250～350Pa·s(10rpm)
面積抵抗値	≦5.0mΩ(10μm換算膜厚)
密着強度	≧3kgf(30N)/2mm□

推奨使用条件

乾燥	大気中120℃以下、5分～30分
焼成	窒素中ピーク600℃以上で9分以上 (酸素濃度≦50ppm)
はんだ	Sn-3.0Ag-0.5Cu

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問合わせはこちら▸ https://crossmining.smm.co.jp/

X-MINING

MINING THE FUTURE
住友金属鉱山
SUMITOMO METAL MINING